



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20081216000

2008 年 12 月 18 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 品質保証部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 (牧)

HVAL-SLL (汎用リニアロジック) 一部製品 UMC 社 ASL3C プロセス追加のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☐ Site ☒ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Assembly	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	HVAL-SLL (汎用リニアロジック) 一部製品 UMC 社 ASL3C プロセス追加 現行：認定済みプロセス 変更後：認定済みプロセス及び UMC 社(台湾) ASL3C プロセス	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	2009 年 3 月下旬の出荷より予定しています。 (サンプルについては、12 月下旬より予定しています。)	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり
備考	—	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：弊社 HVAL-SLL (汎用リニアロジック) 一部製品について、認定済みプロセスに加え、UMC社(台湾)での ASL3C5_RW (50b10. 1) レトログレードウェルプロセスを追加し認定いたしました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
前処理プロセス	認定済みプロセス	認定済みプロセス
		UMC社 ASL3C5_RW (50b10. 1) プロセス

評価用サンプル/開始期日：	SN74LVC16245ADLR	2008年 12月下旬
	SN74LVC16245ADGGR	2008年 12月下旬
	74LVC16245ADGVR	2008年 12月下旬
	SN74LVC16245AZQLR	2008年 12月下旬
	SN74LVC32245ZKER	2008年 12月下旬

理由：UMC 社追加認定による製品供給能力拡大の為

対象製品リスト

対象製品名				
74LVC16245ADGGG4	SN74LVC16245ADGG	SN74LVC16245ADLG4	SN74LVC16245AGRDR	SN74LVC32245ZKER
74LVC16245ADGGRG4	SN74LVC16245ADGGR	SN74LVC16245ADLR	SN74LVC16245AZQLR	
74LVC16245ADGVRE4	SN74LVC16245ADGVR	SN74LVC16245ADLRG4	SN74LVC16245AZRDR	
74LVC16245ADGVRG4	SN74LVC16245ADL	SN74LVC16245AGQLR	SN74LVC32245GKER	

信頼性試験

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	2008 年 9 月 15 日	終了	2009 年 2 月 9 日
信頼性試験結果				
Qual Device: SN74LVC16245ADL				
Reliability Test	Conditions / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot-A	Lot-B	
Autoclave	121C, 96 hrs	77/0	-	
Biased HAST	130C/85%RH, 96 hrs	77/0	-	
High Temp Storage Bake	150C, 1000 hrs	77/0	-	
Steady-State Life Test	150C, 300 hrs	116/0	-	
Temperature Cycle	-65/150C, 1000 cyc	77/0	-	
Bond Strength	Per site mfg. spec	76/0	-	
Die Shear	Per site mfg. spec	12/0	-	
ESD - HBM	2500 V	3/0	-	
ESD - CDM	1000 V	3/0	-	
ESD - MM	150 V	3/0	-	
Electrical Char.	Per device spec	Approved	-	
Latch-up	JESD78, Class II	6/0	-	
Manufacturability (Assembly)	Per site mfg. spec	Approved	-	
Manufacturability (Wafer Fab)	Per site mfg. spec	-	Approved	
Moisture Sensitivity	JEDEC-L1 / 260C	12/0	-	

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	2008 年 9 月 15 日	終了	2009 年 2 月 9 日
信頼性試験結果				
Qual Device: SN74LVCH16245ADL				
Reliability Test	Conditions / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot-A	Lot-B	
Autoclave	121C, 96 hrs	77/0	-	
Biased HAST	130C/85%RH, 96 hrs	77/0	-	
High Temp Storage Bake	150C, 1000 hrs	77/0	-	
Steady-State Life Test	150C, 300 hrs	116/0	-	
Temperature Cycle	-65/150C, 1000 cycles	77/0	-	
Bond Strength	Per site mfg. spec	76/0	-	
Die Shear	Per site mfg. spec	12/0	-	
ESD - HBM	2500 V	3/0	-	
ESD - CDM	1000 V	3/0	-	
ESD - MM	150 V	3/0	-	
Electrical Char.	Per device spec	Approved	-	
Latch-up	JESD78, Class II	6/0	-	
Manufacturability (Assembly)	Per site mfg. spec	Approved	-	
Manufacturability (Wafer Fab)	Per site mfg. spec	-	Approved	
Moisture Sensitivity	JEDEC-L1 / 260C	12/0	-	

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	2008 年 9 月 15 日	終了	2009 年 2 月 9 日
信頼性試験結果				
Qual Device: TS3L500AERHU				
Reliability Test	Conditions / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot-A	Lot-B	
Autoclave	121C, 96 hrs	77/0	-	
Biased HAST	130C/85%RH, 96 hrs	77/0	-	
High Temp Storage Bake	150C, 1000 hrs	77/0	-	
Steady-State Life Test	150C, 300 hrs	116/0	-	
Temperature Cycle	-65/150C, 1000 cycles	77/0	-	
Bond Strength	Per site mfg. spec	76/0	-	
Die Shear	Per site mfg. spec	30/0	-	
ESD - HBM	2000 V	3/0	-	
ESD - CDM	1000 V	3/0	-	
ESD - MM	50 V	3/0	-	
Electrical Char.	Per device spec	Approved	-	
Latch-up	JESD78, Class II	6/0	-	
Manufacturability (Assembly)	Per site mfg. spec	Approved	-	
Manufacturability (Wafer Fab)	Per site mfg. spec	-	Approved	
Moisture Sensitivity	JEDEC-L1 / 260C	12/0	-	